



2027年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

2026年8月7日
東

上場会社名 日本電子材料株式会社

上場取引所

コード番号 6855

URL <https://www.jem-net.co.jp/>

代表者(役職名) 代表取締役社長

(氏名) 坂田 輝久

問合せ先責任者(役職名) 執行役員 管理部門統括部長

(氏名) 石本 浩久

TEL 06-6482-2007

配当支払開始予定日

決算補足説明資料作成の有無 : 無

決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2027年3月期第1四半期の連結業績(2026年4月1日～2026年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2027年3月期第1四半期	9,641	77.3	3,094	109.7	3,192	126.6	2,169	119.4
2026年3月期第1四半期	5,437	8.9	1,475	25.0	1,408	11.4	988	13.8

(注) 包括利益 2027年3月期第1四半期 2,288百万円(259.0%) 2026年3月期第1四半期 637百万円(△42.0%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
2027年3月期第1四半期	148.08	—
2026年3月期第1四半期	78.26	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2027年3月期第1四半期	59,387	46,434	78.2
2026年3月期	58,476	44,878	76.7

(参考) 自己資本 2027年3月期第1四半期 46,434百万円 2026年3月期 44,878百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2026年3月期	—	30.00	—	50.00	80.00
2027年3月期	—	—	—	—	—
2027年3月期(予想)	—	60.00	—	40.00	100.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 有

3. 2027年3月期の連結業績予想(2026年4月1日～2027年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	19,400	57.4	5,400	103.2	5,300	116.4	3,600	111.9	245.78
通期	36,400	24.0	9,450	30.4	9,300	29.6	6,700	22.9	457.42

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 有

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における連結範囲の重要な変更 : 無
新規 — 社(社名) 、除外 — 社(社名)

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
② ①以外の会計方針の変更 : 無
③ 会計上の見積りの変更 : 無
④ 修正再表示 : 無

(4) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2027年3月期1Q	14,663,510株	2026年3月期	14,663,510株
② 期末自己株式数	2027年3月期1Q	16,034株	2026年3月期	16,034株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2027年3月期1Q	14,647,476株	2026年3月期1Q	12,631,504株

※ 添付される四半期連結財務諸表に対する公認会計士又は : 無
監査法人によるレビュー

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	P. 2
(1) 経営成績に関する説明	P. 2
(2) 財政状態に関する説明	P. 2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明	P. 2
2. 四半期連結財務諸表及び主な注記	P. 3
(1) 四半期連結貸借対照表	P. 3
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書	P. 5
(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項	P. 7
(セグメント情報等の注記)	P. 7
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	P. 7
(継続企業の前提に関する注記)	P. 7
(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)	P. 7

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、物価上昇等の影響により消費者マインドに弱さが見られたものの、雇用・所得環境の改善と各種政策の効果により、緩やかな回復基調が続きました。一方、先行きにつきましては、中東情勢の影響、物価上昇、金融資本市場の変動等により、不透明な状況が続きました。

当社グループの主たる事業分野である半導体市場につきましては、生成AI市場の拡大に伴い、データセンター向けを中心に旺盛な需要が継続しました。

このような事業環境の中、メモリー向けプローブカードの拡販が大きく進んだことに加え、為替相場が円安方向に進行したこともあり、売上高は前年同四半期を大きく上回りました。利益面につきましても、売上高の増加に加え、国内工場の高い稼働率により、前年同四半期を大きく上回りました。

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の業績は、売上高9,641百万円（前年同四半期比77.3%増）、営業利益3,094百万円（前年同四半期比109.7%増）、経常利益3,192百万円（前年同四半期比126.6%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益2,169百万円（前年同四半期比119.4%増）となりました。

報告セグメント別の業績は次のとおりです。

a. 半導体検査用部品関連事業

半導体検査用部品関連事業の売上面につきましては、非メモリー向けプローブカードは底堅く推移しました。メモリー向けプローブカードは、国内外の需要の急拡大に対し、生産能力拡大に向けて継続的に進めてきた先行投資が奏功し、生産量が着実に拡大したこと、また、海外向け販売が堅調に推移する中、為替相場が円安方向に進行したことにより、売上高は前年同四半期を大きく上回りました。

利益面につきましても、高付加価値製品を中心とした売上高の増加と国内工場の高い稼働率により、前年同四半期を大きく上回りました。

以上の結果、売上高は9,593百万円（前年同四半期比78.3%増）、セグメント利益は3,624百万円（前年同四半期比88.9%増）となりました。

b. 電子管部品関連事業

電子管部品関連事業につきましては、売上高48百万円（前年同四半期比12.9%減）、セグメント利益は1百万円（前年同四半期比42.8%減）となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末に比べ910百万円増加し、59,387百万円となりました。

これは主として、現金及び預金が2,066百万円減少いたしましたが、電子記録債権が452百万円、売掛金が2,171百万円、仕掛品が388百万円増加したこと等によるものであります。

負債合計は、前連結会計年度末に比べ645百万円減少し、12,952百万円となりました。

これは主として、買掛金が638百万円増加しましたが、未払法人税等が585百万円、賞与引当金が409百万円、長期借入金が312百万円減少したこと等によるものであります。

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1,556百万円増加し、46,434百万円となりました。

これは主として、利益剰余金が1,436百万円、為替換算調整勘定が116百万円増加したこと等によるものであります。

(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

本日（2026年8月7日）「2027年3月期第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想並びに剰余金の配当（中間配当）予想の修正に関するお知らせ」を公表いたしましたのでご参照ください。

なお、2026年7月28日に発生した令和8年熊本地震につきましては、幸い人的被害はありませんでした。また、当社グループの事業所の建物・設備に大きな損害は確認されておらず、現時点において業績への影響は限定的であると判断しております。

2. 四半期連結財務諸表及び主な注記

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,110	25,043
受取手形	0	—
電子記録債権	726	1,178
売掛金	10,609	12,781
有価証券	41	42
製品	574	512
仕掛品	1,768	2,157
原材料及び貯蔵品	2,234	2,366
その他	523	537
貸倒引当金	△23	△35
流動資産合計	43,566	44,583
固定資産		
有形固定資産		
建物及び構築物（純額）	5,196	5,163
機械装置及び運搬具（純額）	2,798	3,097
建設仮勘定	2,070	1,918
その他（純額）	2,852	2,810
有形固定資産合計	12,917	12,989
無形固定資産	281	268
投資その他の資産		
その他	1,711	1,546
貸倒引当金	△0	△0
投資その他の資産合計	1,710	1,545
固定資産合計	14,909	14,803
資産合計	58,476	59,387
負債の部		
流動負債		
電子記録債務	661	896
買掛金	840	1,479
設備電子記録債務	49	21
1年内償還予定の社債	100	100
1年内返済予定の長期借入金	1,249	1,249
未払法人税等	1,421	835
賞与引当金	723	313
その他	1,886	1,585
流動負債合計	6,932	6,481
固定負債		
社債	2,700	2,700
長期借入金	3,494	3,181
その他	470	589
固定負債合計	6,665	6,471
負債合計	13,597	12,952

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (2026年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (2026年6月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	9,205	9,205
資本剰余金	9,424	9,424
利益剰余金	25,017	26,454
自己株式	△16	△16
株主資本合計	43,630	45,067
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	11	14
為替換算調整勘定	1,236	1,353
その他の包括利益累計額合計	1,248	1,367
純資産合計	44,878	46,434
負債純資産合計	58,476	59,387

(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
売上高	5,437	9,641
売上原価	2,639	5,081
売上総利益	2,797	4,560
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	304	371
退職給付費用	5	5
研究開発費	436	403
その他	576	686
販売費及び一般管理費合計	1,322	1,466
営業利益	1,475	3,094
営業外収益		
受取利息	7	5
受取配当金	2	2
為替差益	—	118
その他	12	4
営業外収益合計	22	131
営業外費用		
支払利息	11	12
社債利息	1	10
為替差損	75	—
固定資産廃棄損	0	9
その他	0	0
営業外費用合計	89	33
経常利益	1,408	3,192
税金等調整前四半期純利益	1,408	3,192
法人税、住民税及び事業税	239	712
法人税等調整額	180	310
法人税等合計	420	1,022
四半期純利益	988	2,169
親会社株主に帰属する四半期純利益	988	2,169

四半期連結包括利益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
四半期純利益	988	2,169
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△0	2
為替換算調整勘定	△351	116
その他の包括利益合計	△351	119
四半期包括利益	637	2,288
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	637	2,288

(3) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(セグメント情報等の注記)

前第1四半期連結累計期間(自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
	半導体検査用 部品関連事業	電子管部品 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	5,381	55	5,437	—	5,437
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	5,381	55	5,437	—	5,437
セグメント利益	1,918	2	1,920	△ 445	1,475

(注) 1. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

当第1四半期連結累計期間(自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位: 百万円)

	報告セグメント			調整額 (注1)	四半期連結損益 計算書計上額 (注2)
	半導体検査用 部品関連事業	電子管部品 関連事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	9,593	48	9,641	—	9,641
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	9,593	48	9,641	—	9,641
セグメント利益	3,624	1	3,625	△ 531	3,094

(注) 1. セグメント利益の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない当社の総務・経理部門等の管理部門に係る費用であります。

2. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(キャッシュ・フロー計算書に関する注記)

当第1四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第1四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

	前第1四半期連結累計期間 (自 2025年4月1日 至 2025年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 2026年4月1日 至 2026年6月30日)
減価償却費	347百万円	361百万円